



台光電子材料股份有限公司

全球環保基材的領航者

法人說明會簡報
110年5月

免責聲明

本簡報之內容可能包括本公司基於從各項來源所取得的資訊，對於營運、財務狀況與企業發展情形的前瞻性預估。

因為包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、供應鏈變動、全球經濟局勢、匯率波動及其他本公司無控制力之風險等各種因素，實際的營運、財務狀況與企業發展情形，可能會與本公司於預測中明示或默示敘述有差異。

本簡報之內容若有對未來之前瞻性預估，僅反映本公司於發佈當時之看法。本公司並無義務於日後情況變更時，更新前瞻預估。

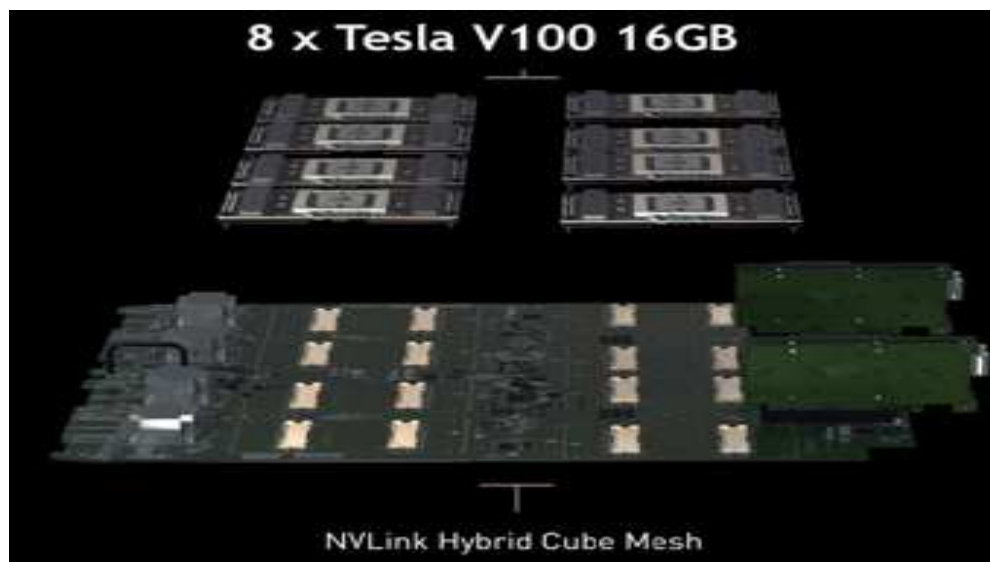
簡報大綱

- 銅箔基板產業展望
- 公司長期財務績效
- 附註

網通板設計趨勢朝向細線路高密度互連技術發展

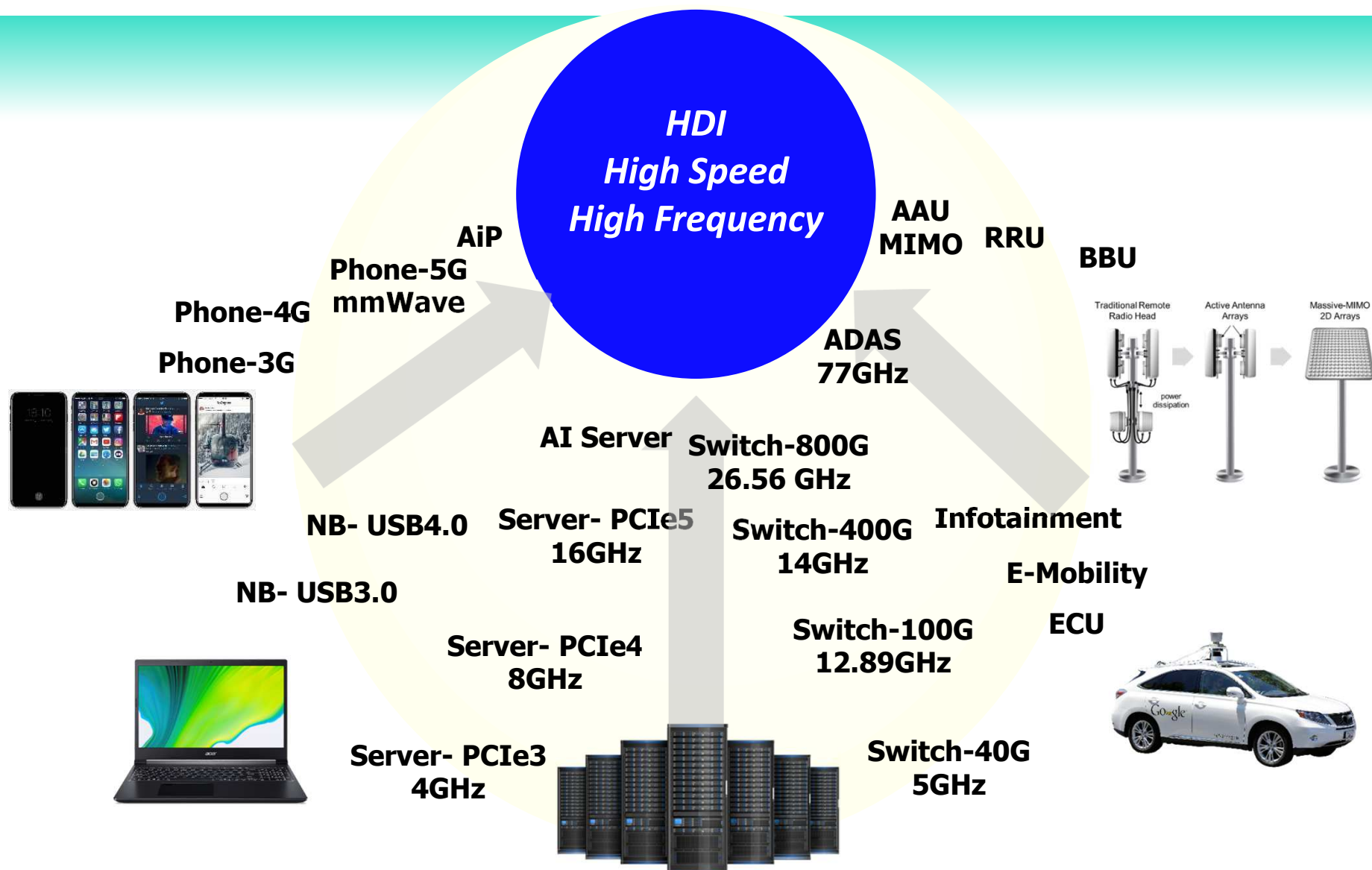
- 趨勢一：無鹵素環保基材–已成為網通業者偏好或指定的材料
PCIe4的網通產品，例如但非僅限於Intel開發的Whitely伺服器平台，皆要求必須採用無鹵素基材。
- 趨勢二：高密度互連技術–AI 晶片、GPU及CPU，以及半導體的異質整合技術，皆使接腳數目呈幾何級數增加
縮小線寬線距，已成為PCB業者普遍採用的設計趨勢。
- 趨勢三：高密度互連技術的工藝成為高階網通板的必須製造技術。
- 台光在無鹵素及高密度互連技術多年來累積的經驗及知識，已成為同業望塵莫及的競爭優勢。

多組GPU成為超高速運算AI Server



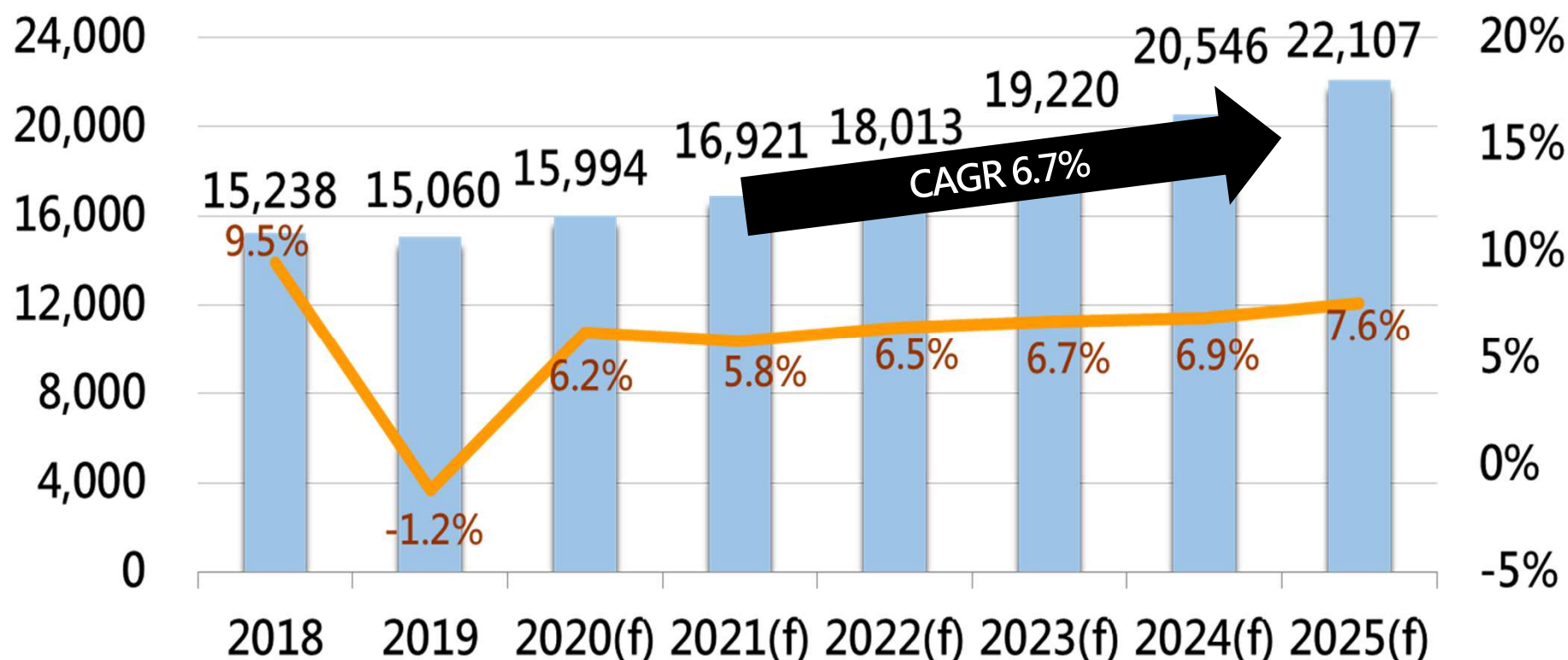
Source: nVidia

5G基礎建設材料的發展趨勢：高密度連結，高速，高頻



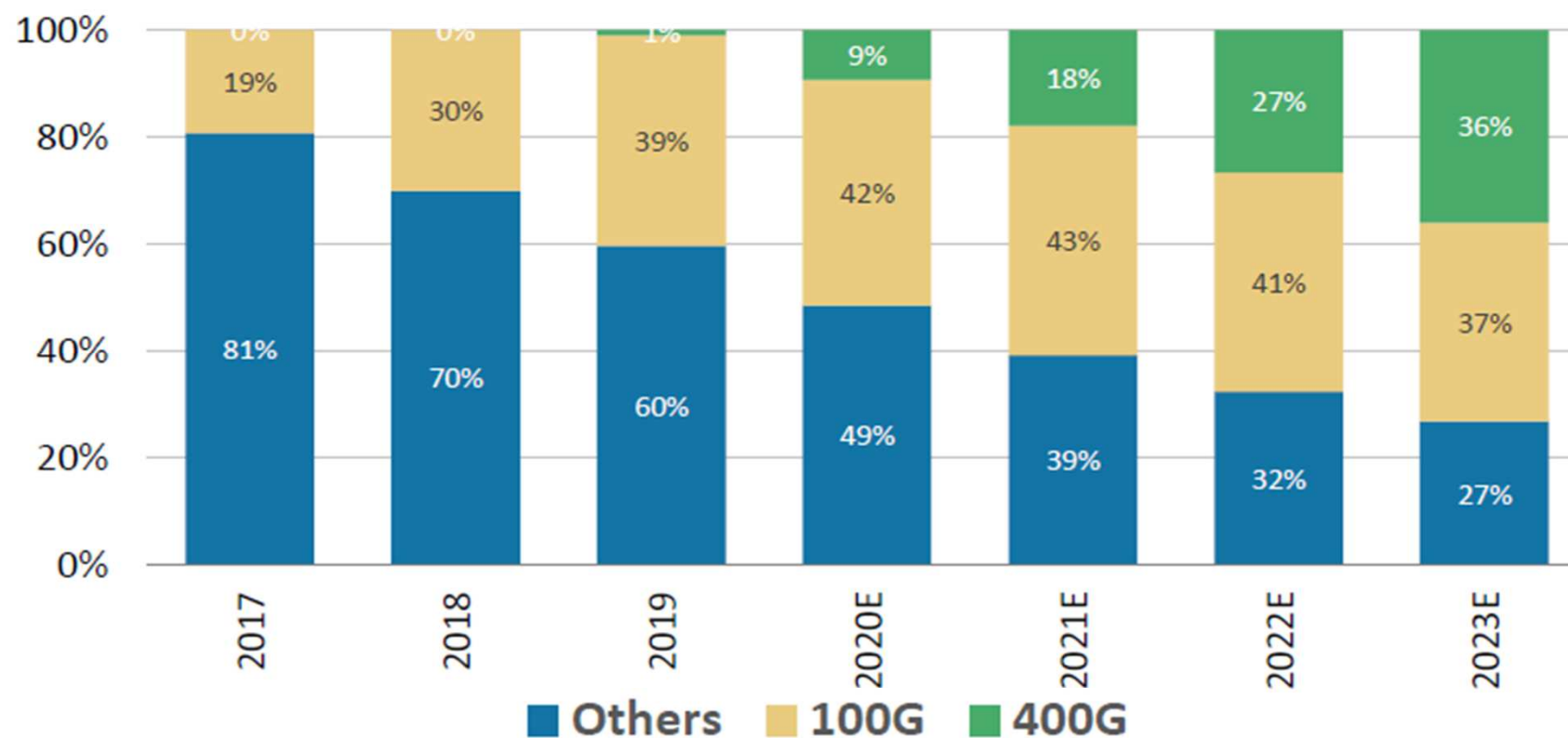
伺服器末年五年的複合成長率達 6.7%

Unit : k set



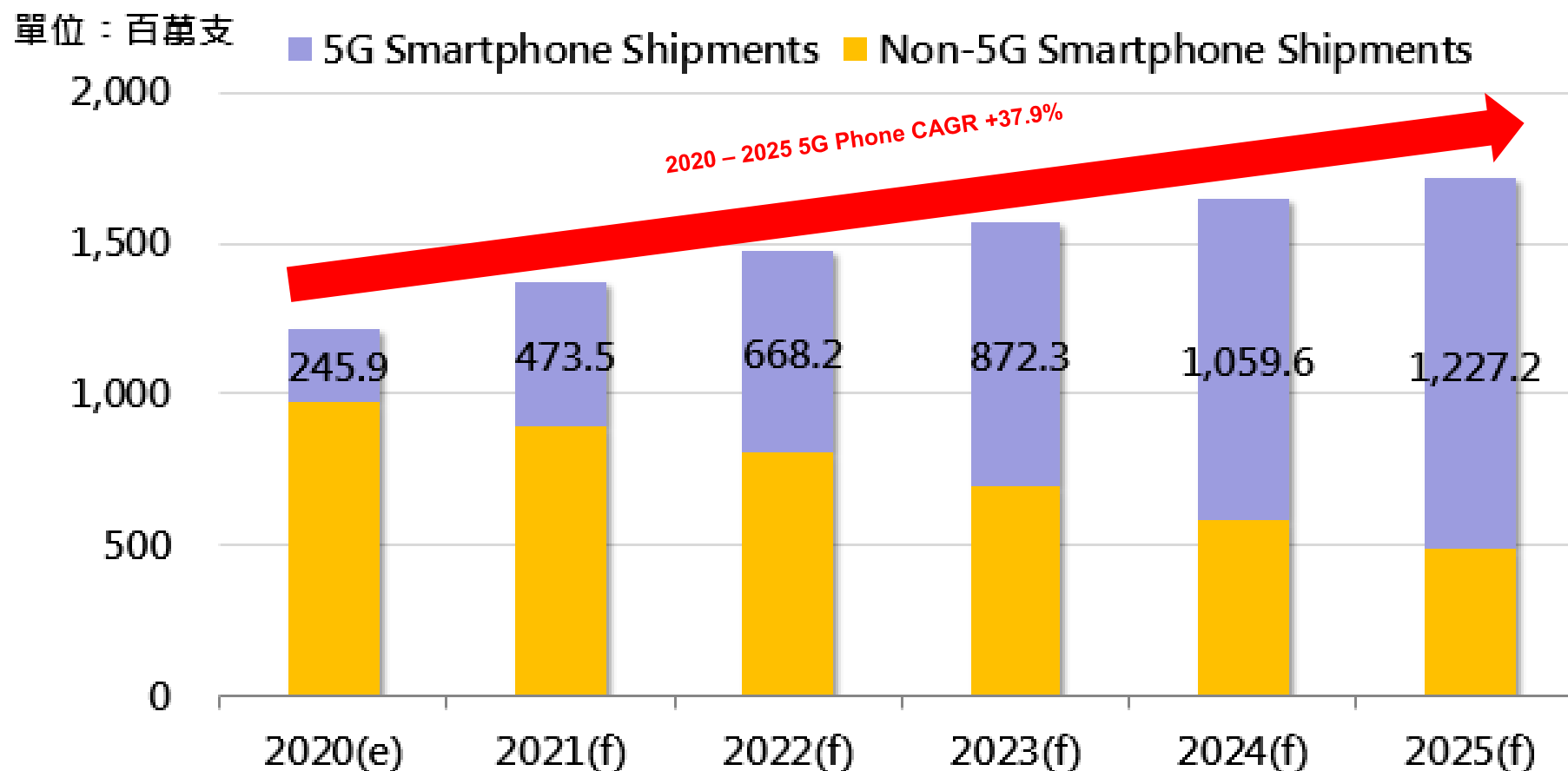
100/400G 交換器將成為主流

2017~2023 switch split



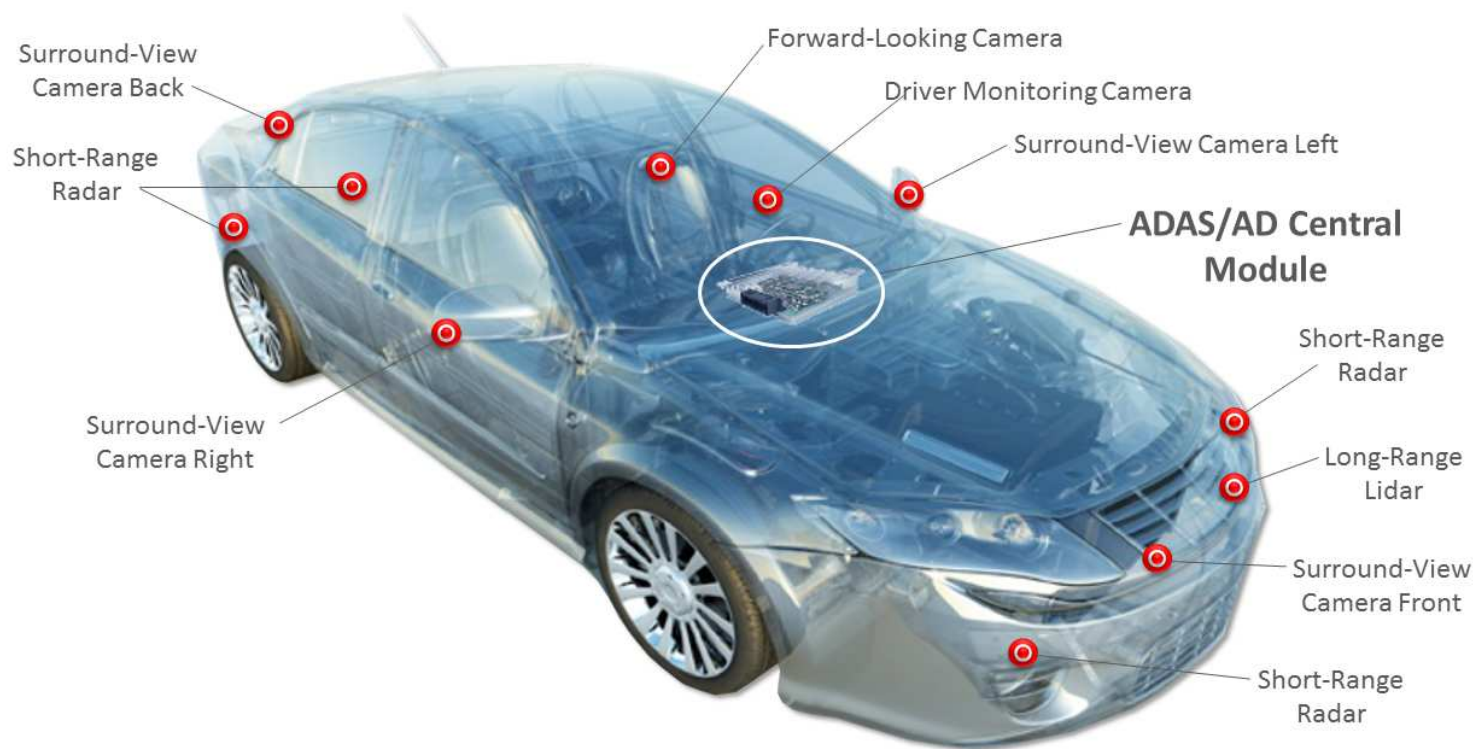
Source: IDC, Morgan Stanley Research

5G手機的複合成長率達37.9%



資料來源：DIGITIMES Research，2020/9

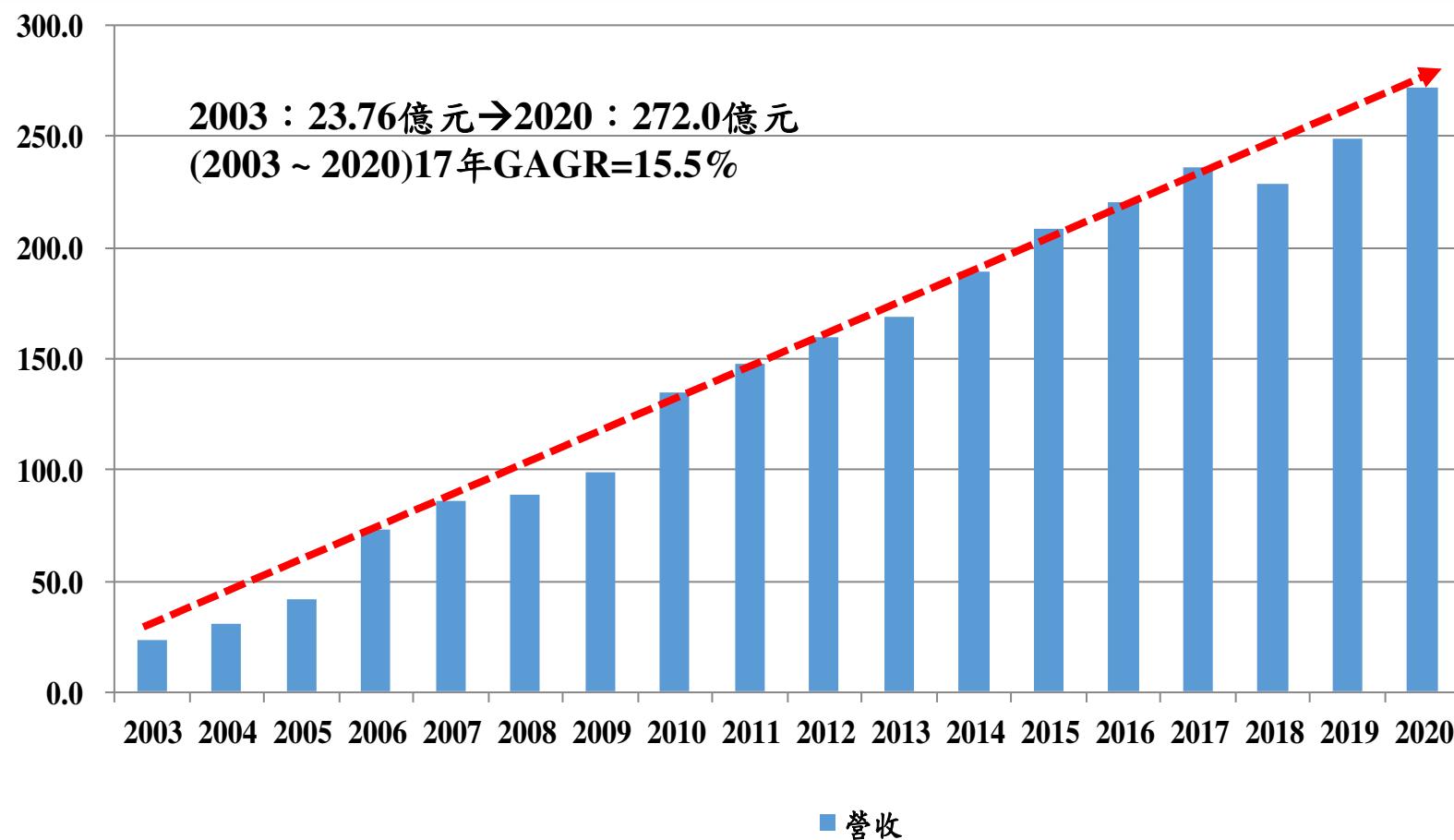
汽車電動化及智能化勢必採用高密度互連板



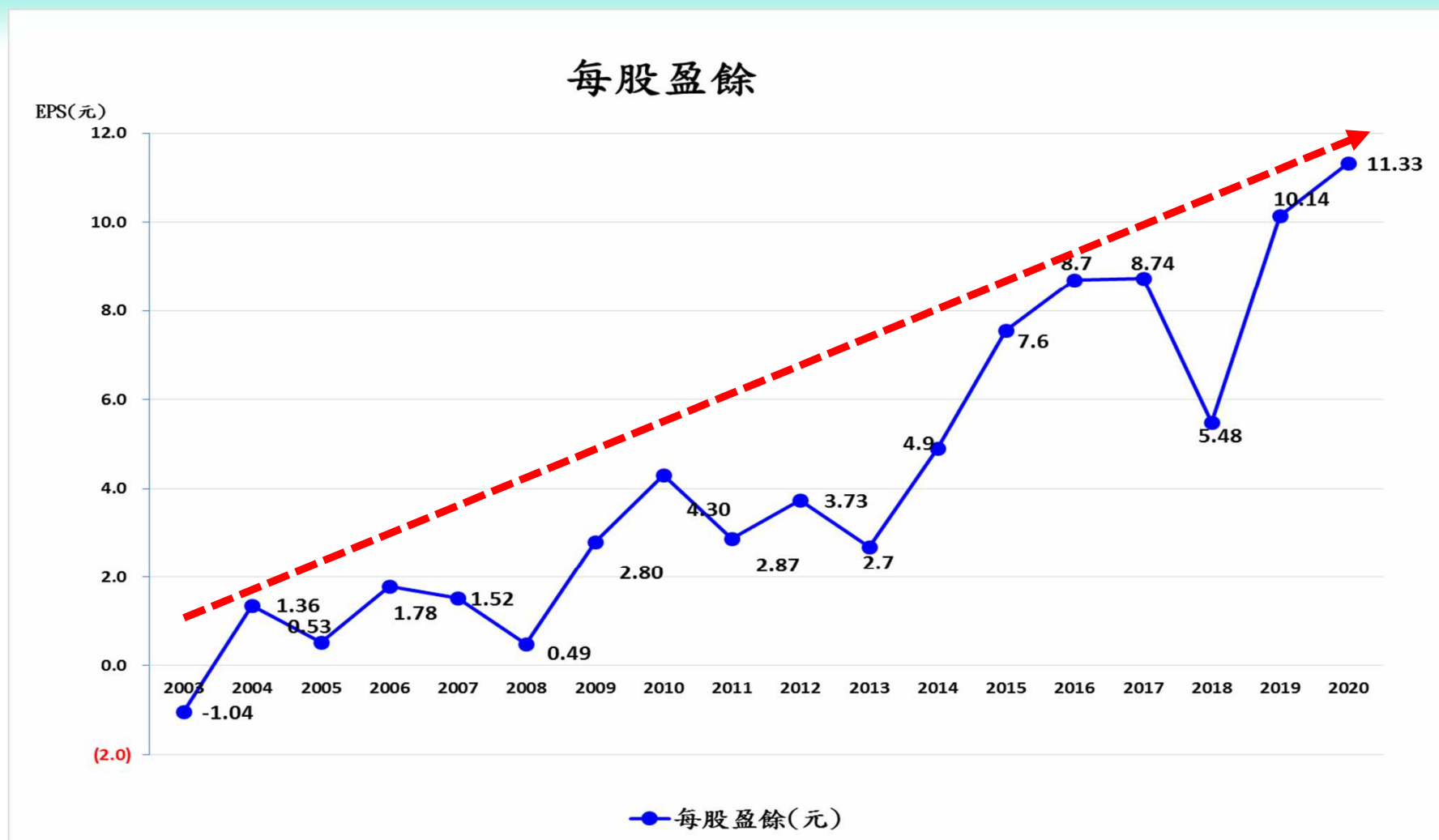
高密度互連板在汽車領域的應用在未來10年的滲透率可望大幅成長，特別是應用在高級駕駛輔助系統，車用資訊娛樂系統，及智慧車載系統。

營收成長趨勢

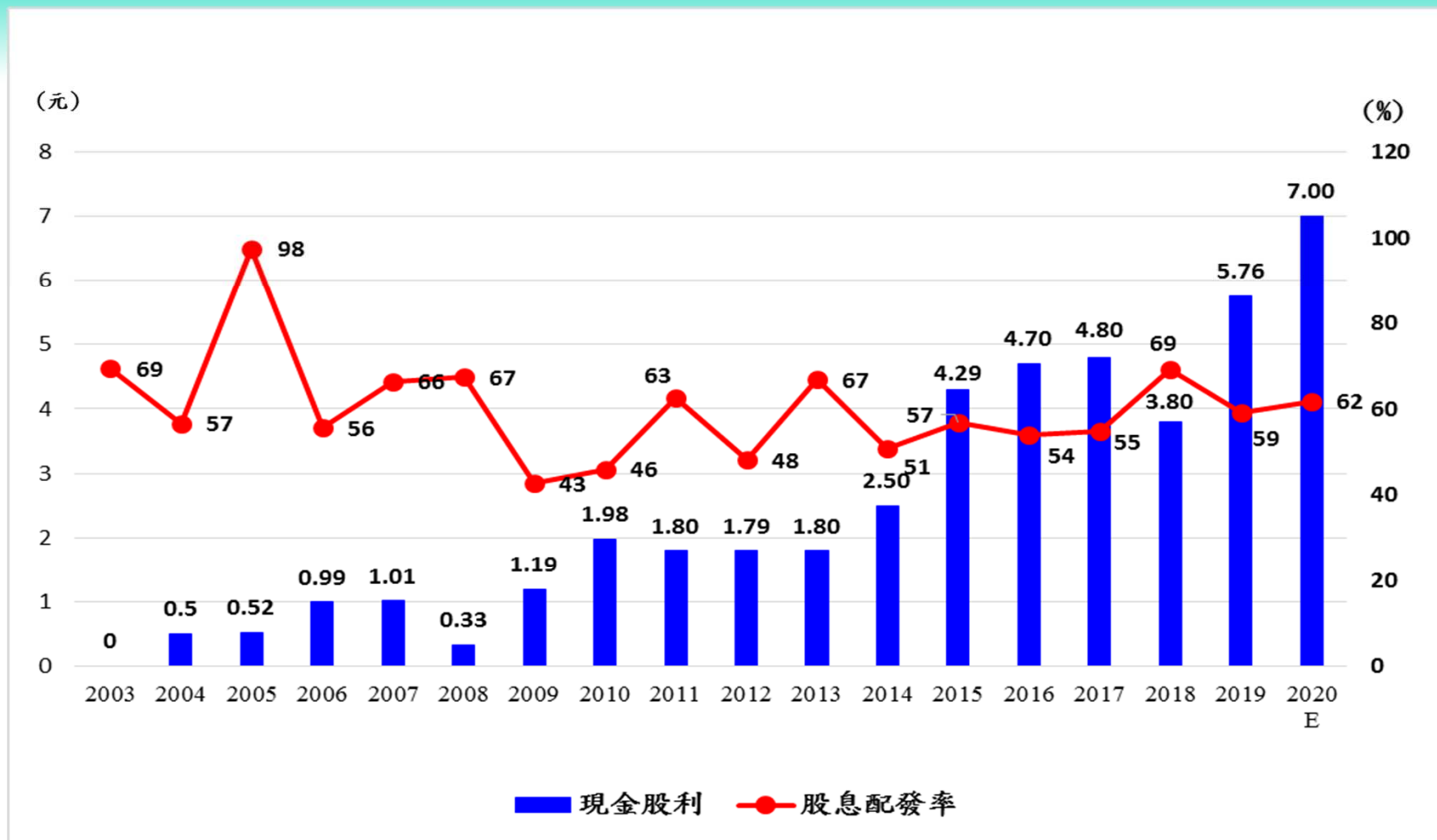
營收：新台幣億元



經營績效趨勢



每股現金股息暨股息配發率



損益表摘要

單位:新台幣百萬元

	1Q21	4Q20	QoQ	1Q20	YoY
營業收入	8,004	7,517	6.5%	5,909	35.4%
營業毛利	1,887	1,876	0.6%	1,431	31.9%
營業利益	1,233	1,203	2.5%	951	29.6%
繼續營業部門稅前淨利	1,224	1,287	-4.9%	954	28.4%
所得稅費用	(259)	(310)	16.3%	(221)	-17.7%
稅後淨利	965	977	-1.3%	733	31.6%
基本每股盈餘(新台幣元)	2.89	2.93	-1.4%	2.29	26.2%
營業毛利率(%)	23.6%	25.0%		24.2%	
營業利益率(%)	15.4%	16.0%		16.1%	
稅後淨利率(%)	12.1%	13.0%		12.4%	

資產負債表摘要

單位:新台幣百萬元

	1Q21		4Q20		1Q20	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
現金及約當現金	6,567	21.5%	5,732	20.6%	7,007	27.1%
應收帳款+應收票據	10,495	34.3%	9,934	35.7%	8,084	31.3%
存貨	4,386	14.3%	3,702	13.3%	3,384	13.1%
不動產、廠房及設備	6,729	22.0%	6,531	23.4%	5,867	22.7%
資產總計	30,609	100.0%	27,857	100.0%	25,825	100.0%
短期借款	1,696	5.5%	1,162	4.2%	903	3.5%
應付帳款	7,018	22.9%	5,847	21.0%	5,461	21.1%
長期借款	300	1.0%	564	2.0%	703	2.7%
業主權益	17,633	57.6%	16,756	60.1%	14,140	54.8%
負債及權益	30,609	100.0%	27,857	100.0%	25,825	100.0%

附註

公司簡介-全球生產基地及主要據點



■ 台光集團概況

股票代號
成立日期
員工人數
月產能:

2383
1992
3,200+
355 萬張/ 月 (銅箔基板)
1070 萬公尺/ 月 (黏合片)
80 萬平方呎/ 月 (多層壓合代工)
4萬片/ 月 (金屬基板)

資本額

美金 0.96 億元

營收 (2020年合併淨額): 美金 9.20 億元

資格認證

ISO-9001, ISO-14001, IATF-16949,
ISO-45001, QC080000, AS9100C
and Sony Green Partner
E150504

UL 認證編號

生產基地
經銷據點
海外代表處

生產基地及月產能

